

(1,27mm) .050"

LPAM 系列



# 高速薄型开放式连接器

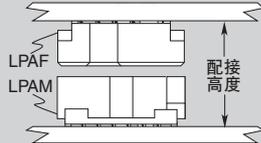
## 技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 [www.samtec.com?LPAM](http://www.samtec.com?LPAM)

绝缘体材料:  
黑色液晶聚合物  
端子材料:  
铜合金  
电镀:  
在 50μ" (1.27μm) 镍上镀金或锡  
触点电阻:  
测试中!  
额定电流:  
测试中!  
性能:  
测试中!  
工作电压:  
测试中!  
符合 RoHS 规范要求:  
是可无铅焊接:  
是

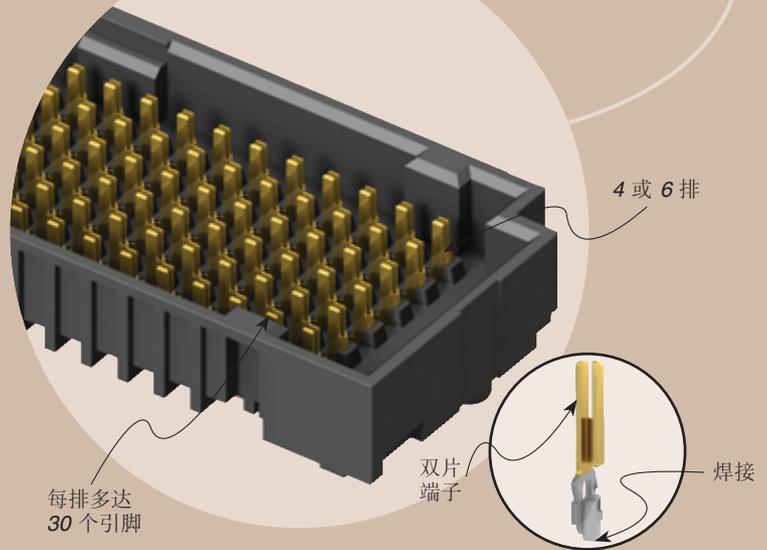
配件:  
LPAF

### 配接高度



LPAM 引线式样	LPAF 引线式样	
	-03.0	-03.5
-01.0	(4,00) .157	(4,50) .177
-01.5	(4,50) .177	(5,00) .197

\*加工条件将影响配接高度。

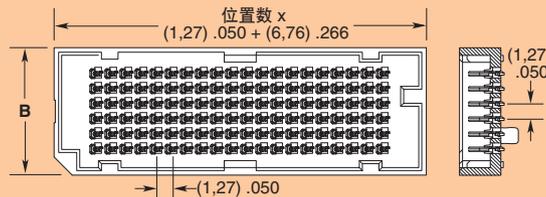


## 还提供

- 锡铅焊接。
  - 其他引脚/排和排数。
  - 其他镀金选项。
- 请致电 Samtec。

<b>LPAM</b>	<b>每排引脚数</b>	<b>引线式样</b>	<b>电镀选项</b>	<b>排数</b>	<b>2</b>	<b>选项</b>	<b>TR</b>
	-10, -20, -30 (每排)	-01.0 = (1.0mm) .039" -01.5 = (1.5mm) .060"	-L = 触点区域镀 10μ" (0.25μm) 的金, 焊尾上镀雾锡	-04 = 四排 -06 = 六排	-2 = 无铅锡合金 95.5% 锡/3.8% 银/0.7% 铜 焊接	-K = 聚酰亚胺膜 取放垫	-TR = 卷带 封装

排数	B
-04	(8,18) .322
-06	(10,72) .422



引线式样	A
-01.0	(3,68) .145
-01.5	(4,19) .165

注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型, 不可退换。